**技术创新需求调查表**

**企业信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海笙荣森电子有限公司 | 机构代码 | 913101187514859936 |
| 区域 | 上海市-青浦区 | 联系人 | 谈叶婷 | 电话 | 13661803539 |
| 行业领域 |  | 新材料 | 产业领域 |  | 半导体发光材料 |
| 经济规模 |  | 6000万 | 人员规模 | 65 |

**需求信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术需 | □ 技术研发（关键、核心技术） □ 产品研发（产品升级，新 |  |
| 产品研发） |  |
| 求类别 |  |
| □ 技术改造（设备，研发生产条件） √ 技术配套（技术，产 |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  | GaN基LED虽然经过近20年的研究和发展，单仍存在一些问题 |  |
|  | ，如何量产性能良好的大功率LED芯片仍然需要技术的突破和 |  |
|  | 攻关。本公司需求一种稳定可靠的GaN基大功率LED芯片，以 |  |
|  | 替代目前的蓝宝石衬底及硅衬底芯片。 |  |
| 技术 |  |  |
| 需求 |  |  |
| 简述 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.GaN外延片的内量子功率达到50%，1mm\*1mm大功率芯片光 |  |
|  | 输出功率达到300mw。2.通过芯片结构设计以提高取光效率。 |  |
|  | 3.通过电极设计以提高电流注入效率并获得均匀的电流分布。 |  |
| 技 | 4.具有可靠性和稳定性，并能量产化。5.成本与常规芯片基本 |  |
| 持平。 |  |
| 术 |  |
|  |  |
| 需 |  |  |
| 求 |  |  |
| 情 |  |  |
| 况 | 技术 |  |
| 说 |  |
| 需求 |  |
| 明 |  |
| 详述 |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 现有 | 公司主要生产和销售各类LED照明灯具，大功率LED芯片年使 |
| 基础 | 用量巨大，目前基本使用非GaN基芯片，因为受到材料特性的 |
| 情况 | 影响，不得不在散热等问题上花费大量成本，因此需要一项稳 |

定的大功率芯片技术，以提升公司产品的品质和利润。公司拥有自主生产厂房和研发实验室，实验设备齐全，可以为研发提供一定支持。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 希望有成熟的GaN基大功率LED技术，与相关专家和团队共同 |  |
|  |  | 开发研究，可以以共同成立新公司的形式参与市场化利润的分 |  |
|  |  | 配，专家或团队可以以技术入股，笙荣森公司负责市场的开拓 |  |
|  |  | 与运营。 |  |
|  | 需求 |  |  |  |
|  | 描述 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |  |
| 学 |  |  |  |  |
| 研 |  |  |  |  |
| 合 |  |  |  |  |
| 作 |  |  |  |  |
| 需 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 求 | 合作方式 | □ 技术转让 √ 技术入股 □ 技术联合开发 □ 委托研发 |  |
|  | □ 委托团队、专家长期技术服务 √ 共建新研发、生产实体 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其 | □ 共建新研发、生产实体 □ 研发费用加计扣除 □ 知识产权 □ 科技金融 □ |  |
| 他 |  |
| 检验检测 □ 质量体系 √ 行业政策 √ 科技政策 □ 招标采购 □ 产品、服务 |  |
| 需 |  |
| 市场占有率分析 □ 市场前景分析 □ 企业发展战略咨询 □ 其他 |  |
| 求 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **管理信息** |  |
| 同意公开需求信息 | √ 是 | □ 否 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 同意接受技术服务 | √ 是 |  |  |
| □ 否 |  |  |
|  |  |  |  |

同意参与对解决方案 √ 是

的筛选评价 □ 否

□ 是，金额 万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件）

√ 否

同意对优秀解决方案

给予奖励

法人代表： 年 月 日